

Technologie, fabrication et industrialisation des systèmes embarqués

 **ECTS**
6 crédits

 **Volume horaire**

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :

- comment rédiger une spécification d'industrialisation d'un système embarqué (BOM, fichiers GERBER, BTF, AMDEC,..)
- comment définir les classes technologiques d'un circuit imprimé (PCB rigide, souple, hybride)
- comment router les signaux du point de vue contraintes en adéquation avec les aspects dissipation thermique et intégrité du signal
- comment définir le type de montage d'une carte (fusion, simple/double, type de finitions)
- comment être conformes aux différentes normes (NF 93-713, RTTE, DBT, RoHS, DEEE)
- comment mettre en place un processus de suivi qualité (ISO17025)
- comment estimer la fiabilité de l'assemblage (norme FIDES)

L'étudiant devra être capable de :

Connaitre toutes les étapes de fabrication, les méthodes de conception et les normes/conformités de mise sur le marché économique d'un produit électronique.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse